

2023-2029年中国集成电路 设计行业“专精特新”行业分析与发展前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国集成电路设计行业“专精特新”行业分析与发展前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202307/385533.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国集成电路设计行业“专精特新”行业分析与发展前景报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国集成电路设计行业“专精特新”发展概述

1.1 集成电路设计行业的界定

1.1.1 集成电路设计的界定

1.1.2 集成电路设计所处产业链环节

1.1.3 集成电路设计行业分类

1.1.4 集成电路设计所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

1.2.1 “专精特新”概念解读

1.2.2 “专精特新”相关概念辨析

（1）“专精特新”“小巨人”

（2）专精特新中小企业

（3）其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析

（1）中国中小企业发展现状

（2）中国制造业发展现状

（3）服务“国内国际双循环”发展格局

1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析

（1）全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡

（2）中国高科技发展遭遇“卡脖子”

1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：全球及中国集成电路设计行业发展现状分析

2.1 全球集成电路设计行业发展现状

2.1.1 全球集成电路设计行业发展规模

2.1.2 全球集成电路设计行业区域发展格局

2.1.3 全球集成电路设计行业企业竞争格局

2.2 中国集成电路设计行业发展现状

2.2.1 中国集成电路设计行业发展规模

2.2.2 中国集成电路设计行业区域发展格局

2.2.3 中国集成电路设计行业企业竞争格局

2.3 中国集成电路设计行业技术水平及国产化现状

2.3.1 中国集成电路设计行业技术发展现状

(1) 集成电路设计行业技术创新现状

(2) 集成电路设计行业专利申请情况

(3) 集成电路设计行业技术研发趋势

2.3.2 中国集成电路设计行业国产化发展现状

(1) 集成电路设计行业国产化率分析

(2) 集成电路设计行业本土企业布局

2.4 中国集成电路设计行业发展机遇与挑战分析

第3章：中国集成电路设计行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

3.1 中国集成电路设计行业“专精特新”政策环境分析

3.1.1 国家层面集成电路设计行业发展相关政策及规划汇总解读

(1) 集成电路设计行业发展相关政策汇总

(2) 集成电路设计行业发展相关规划汇总

3.1.2 国家层面集成电路设计行业“专精特新”相关政策汇总解读

3.1.3 国家“十四五”规划对集成电路设计行业发展的影响分析

3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对集成电路设计行业的影响分析

3.1.5 集成电路设计行业“专精特新”发展的政策机遇分析

3.2 中国集成电路设计行业“专精特新”投融资环境分析

3.2.1 中国集成电路设计行业“专精特新”领域主要资金来源

3.2.2 中国集成电路设计行业“专精特新”领域投融资主体

- 3.2.3 中国集成电路设计行业“专精特新”领域投融资方式
- 3.2.4 中国集成电路设计行业“专精特新”领域投融资事件汇总
- 3.2.5 中国集成电路设计行业“专精特新”领域投融资机遇分析
 - (1) 集成电路设计行业“专精特新”财税扶持力度
 - (2) 集成电路设计行业“专精特新”信贷支持政策
 - (3) 集成电路设计行业“专精特新”市场化融资渠道
 - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
- 3.3 中国集成电路设计行业“专精特新”发展战略支撑及保障

第4章：中国集成电路设计行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读

- 4.1 中国集成电路设计行业“专精特新”企业培育方案解读
 - 4.1.1 集成电路设计行业国家级“专精特新”企业培育目的
 - 4.1.2 集成电路设计行业国家级“专精特新”企业培育对象
 - 4.1.3 集成电路设计行业国家级“专精特新”企业培育内容
 - 4.1.4 集成电路设计行业国家级“专精特新”企业培育措施
 - 4.1.5 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业奖励标准
- 4.2 中国集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业申报条件及流程解读
 - 4.2.1 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业申报-基本条件
 - 4.2.2 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业申报-专项条件
 - 4.2.3 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业申报-分类条件
 - 4.2.4 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业申报流程解读
- 4.3 中国集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业培育现状分析
 - 4.3.1 全国“专精特新”“小巨人”企业培育现状
 - (1) “专精特新”“小巨人”企业培育进展
 - (2) “专精特新”“小巨人”企业培育特征
 - (3) “专精特新”“小巨人”企业行业分布
 - 4.3.2 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业培育现状
 - (1) 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业培育进展
 - (2) 集成电路设计行业“专精特新”“小巨人”企业培育特征

第5章：中国集成电路设计产业链全景梳理及“专精特新”鼓励布局方向

- 5.1 中国集成电路设计产业结构属性（产业链）分析

- 5.1.1 中国集成电路设计产业链结构梳理
- 5.1.2 中国集成电路设计产业链生态图谱
- 5.2 中国集成电路设计产业价值属性（价值链）分析
 - 5.2.1 中国集成电路设计行业成本结构分析
 - 5.2.2 中国集成电路设计行业价值链分析
- 5.3 中国集成电路设计行业发展痛点分析
- 5.4 中国集成电路设计产业链“专精特新”鼓励布局方向

第6章：中国集成电路设计产业链环节“专精特新”布局状况研究

- 6.1 中国集成电路设计行业之服务器CPU“专精特新”布局状况研究
 - 6.1.1 中国集成电路设计行业之服务器CPU发展现状分析
 - （1）服务器CPU市场发展规模
 - （2）服务器CPU技术发展现状
 - （3）服务器CPU国产化发展现状
 - 6.1.2 中国集成电路设计行业之服务器CPU发展痛点分析
 - 6.1.3 中国集成电路设计行业之服务器CPU“专精特新”市场培育现状
 - 6.1.4 中国集成电路设计行业之服务器CPU市场竞争格局分析
 - 6.1.5 中国集成电路设计行业之服务器CPU发展前景及趋势分析
- 6.2 中国集成电路设计行业之桌面CPU“专精特新”布局状况研究
 - 6.2.1 中国集成电路设计行业之桌面CPU发展现状分析
 - （1）桌面CPU市场发展规模
 - （2）桌面CPU技术发展现状
 - （3）桌面CPU国产化发展现状
 - 6.2.2 中国集成电路设计行业之桌面CPU发展痛点分析
 - 6.2.3 中国集成电路设计行业之桌面CPU“专精特新”市场培育现状
 - 6.2.4 中国集成电路设计行业之桌面CPU市场竞争格局分析
 - 6.2.5 中国集成电路设计行业之桌面CPU发展前景及趋势分析
- 6.3 中国集成电路设计行业之嵌入式CPU“专精特新”布局状况研究
 - 6.3.1 中国集成电路设计行业之嵌入式CPU发展现状分析
 - （1）嵌入式CPU市场发展规模
 - （2）嵌入式CPU技术发展现状
 - （3）嵌入式CPU国产化发展现状

- 6.3.2 中国集成电路设计行业之嵌入式CPU发展痛点分析
- 6.3.3 中国集成电路设计行业之嵌入式CPU“专精特新”市场培育现状
- 6.3.4 中国集成电路设计行业之嵌入式CPU市场竞争格局分析
- 6.3.5 中国集成电路设计行业之嵌入式CPU发展前景及趋势分析
- 6.4 中国集成电路设计行业之存储器“专精特新”布局状况研究
 - 6.4.1 中国集成电路设计行业之存储器发展现状分析
 - (1) 存储器市场发展规模
 - (2) 存储器技术发展现状
 - (3) 存储器国产化发展现状
 - 6.4.2 中国集成电路设计行业之存储器发展痛点分析
 - 6.4.3 中国集成电路设计行业之存储器“专精特新”市场培育现状
 - 6.4.4 中国集成电路设计行业之存储器市场竞争格局分析
 - 6.4.5 中国集成电路设计行业之存储器发展前景及趋势分析
- 6.5 中国集成电路设计行业之FPGA芯片“专精特新”布局状况研究
 - 6.5.1 中国集成电路设计行业之FPGA芯片发展现状分析
 - (1) FPGA芯片市场发展规模
 - (2) FPGA芯片技术发展现状
 - (3) FPGA芯片国产化发展现状
 - 6.5.2 中国集成电路设计行业之FPGA芯片发展痛点分析
 - 6.5.3 中国集成电路设计行业之FPGA芯片“专精特新”市场培育现状
 - 6.5.4 中国集成电路设计行业之FPGA芯片市场竞争格局分析
 - 6.5.5 中国集成电路设计行业之FPGA芯片发展前景及趋势分析
- 6.6 中国集成电路设计行业之EDA工具“专精特新”布局状况研究
 - 6.6.1 中国集成电路设计行业之EDA工具发展现状分析
 - (1) EDA工具市场发展规模
 - (2) EDA工具技术发展现状
 - (3) EDA工具国产化发展现状
 - 6.6.2 中国集成电路设计行业之EDA工具发展痛点分析
 - 6.6.3 中国集成电路设计行业之EDA工具“专精特新”市场培育现状
 - 6.6.4 中国集成电路设计行业之EDA工具市场竞争格局分析
 - 6.6.5 中国集成电路设计行业之EDA工具发展前景及趋势分析

第7章：中国集成电路设计行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

7.1 中国集成电路设计产业资源区域分布状况

7.2 中国集成电路设计行业企业数量区域分布

7.3 中国集成电路设计行业区域发展格局分析

7.4 中国各省市集成电路设计行业“专精特新”政策环境分析

7.5 中国各省市集成电路设计行业“专精特新”企业培育方案及申报条件

7.5.1 集成电路设计行业省市级“专精特新”企业培育方案解读

(1) 省级“专精特新”企业培育方案解读

(2) 市级“专精特新”企业培育方案解读

7.5.2 集成电路设计行业省市级“专精特新”企业奖励标准

7.5.3 集成电路设计行业省市级“专精特新”企业申报条件解读

(1) 省级“专精特新”企业申报条件

(2) 市级“专精特新”企业申报条件

7.5.4 集成电路设计行业省市级“专精特新”企业申报流程解读

(1) 省级“专精特新”企业申报流程

(2) 市级“专精特新”企业申报流程

7.6 中国各省市集成电路设计行业“专精特新”市场培育现状

7.6.1 各省市集成电路设计行业“专精特新”企业培育规模

7.6.2 各省市集成电路设计行业“专精特新”市场培育格局

7.6.3 各省市集成电路设计行业“专精特新”市场培育特征

第8章：中国集成电路设计行业代表性“小巨人”企业布局对比及案例研究

8.1 中国集成电路设计行业代表性“小巨人”企业布局对比

8.2 中国集成电路设计行业代表性“小巨人”企业布局案例研究

8.2.1 灿芯半导体（上海）股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路设计产业链布局状况

(5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.2 龙迅半导体（合肥）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路设计产业链布局状况
- (5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.3 深圳市力合微电子股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路设计产业链布局状况
- (5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.4 成都士兰半导体制造有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路设计产业链布局状况
- (5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.5 厦门亿芯源半导体科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路设计产业链布局状况
- (5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.6 上海富瀚微电子股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路设计产业链布局状况

(5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.7 圣邦微电子（北京）股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路设计产业链布局状况

(5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.8 杭州中科微电子有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路设计产业链布局状况

(5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.9 无锡芯朋微电子股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路设计产业链布局状况

(5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

8.2.10 北京昂瑞微电子科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业集成电路设计业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路设计产业链布局状况

(5) 企业集成电路设计业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路设计业务布局优劣势分析

第9章：中国集成电路设计行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

9.1 中国集成电路设计行业市场前景预测

9.2 中国集成电路设计行业“专精特新”发展趋势预判

9.3 中国集成电路设计行业“专精特新”发展前景预测

第10章：中国集成电路设计行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

10.1 中国集成电路设计行业“专精特新”投资特性分析

10.1.1 中国集成电路设计行业“专精特新”投资壁垒分析

10.1.2 中国集成电路设计行业“专精特新”投资风险预警及防范

10.2 中国集成电路设计行业“专精特新”投资价值评估

10.3 中国集成电路设计行业“专精特新”投资机会分析

10.3.1 产业链薄弱环节投资机会

10.3.2 区域市场投资机会

10.3.3 细分市场投资机会

10.4 中国集成电路设计行业“专精特新”潜在发展方向分析

第11章：中国集成电路设计行业“专精特新”投资策略及发展建议

11.1 中国集成电路设计行业“专精特新”投资策略

11.2 中国集成电路设计行业“专精特新”发展建议

图表目录

图表1：中国集成电路设计行业本土企业布局情况

图表2：中国集成电路设计行业发展机遇与挑战分析

图表3：截至2021年中国集成电路设计行业发展政策汇总-国家层面

图表4：截至2021年中国集成电路设计行业发展规划汇总-国家层面

图表5：截至2021年中国集成电路设计行业“专精特新”发展政策解读-国家层面

图表6：中国集成电路设计行业发展痛点分析

图表7：中国集成电路设计行业服务器CPU本土企业布局情况

图表8：中国集成电路设计行业设计行业发展痛点分析

图表9：中国集成电路设计行业之桌面CPU本土企业布局情况

图表10：中国集成电路设计行业之桌面CPU发展痛点分析

图表11：中国集成电路设计行业之嵌入式CPU本土企业布局情况

图表12：中国集成电路设计行业之嵌入式CPU发展痛点分析

- 图表13：中国集成电路设计行业之存储器本土企业布局情况
- 图表14：中国集成电路设计行业之存储器发展痛点分析
- 图表15：中国集成电路设计行业之FPGA芯片本土企业布局情况
- 图表16：中国集成电路设计行业之FPGA芯片发展痛点分析
- 图表17：中国集成电路设计行业之EDA工具本土企业布局情况
- 图表18：中国集成电路设计行业之EDA工具发展痛点分析
- 图表19：灿芯半导体（上海）股份有限公司发展历程
- 图表20：灿芯半导体（上海）股份有限公司基本信息表
- 图表21：灿芯半导体（上海）股份有限公司股权穿透图
- 图表22：灿芯半导体（上海）股份有限公司经营状况
- 图表23：灿芯半导体（上海）股份有限公司整体业务架构
- 图表24：灿芯半导体（上海）股份有限公司销售网络布局
- 图表25：灿芯半导体（上海）股份有限公司集成电路设计业务布局优劣势分析
- 图表26：龙迅半导体（合肥）股份有限公司发展历程
- 图表27：龙迅半导体（合肥）股份有限公司基本信息表
- 图表28：龙迅半导体（合肥）股份有限公司股权穿透图
- 图表29：龙迅半导体（合肥）股份有限公司经营状况
- 图表30：龙迅半导体（合肥）股份有限公司整体业务架构
- 图表31：龙迅半导体（合肥）股份有限公司销售网络布局

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202307/385533.html>